## Гашение тока светом в диодных структурах p-Si- $n^+$ -ZnO-n-ZnO-Pd

© С.В. Слободчиков, Х.М. Салихов, Е.В. Руссу, Ю.Г. Малинин

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук, 194021 Санкт-Петербург, Россия

(Получена 30 августа 2000 г. Принята к печати 5 сентября 2000 г.)

Исследован механизм токопереноса и фотоэлектрические характеристики анизотипной гетероструктуры с контактом Шоттки *p*-Si- $n^+$ -ZnO-n-ZnO-Pd. Выявленная зависимость  $I \propto V^3$  объяснена двойной инжекцией носителей в дрейфовом приближении. Обнаружено гашение (уменьшение) прямого тока при освещении светом в интервале  $\lambda = 0.7 - 1.2$  мкм. Этот эффект объяснен особенностями захвата световых неосновных носителей, дырок, и их рекомбинации с темновыми электронами.

Кристаллы, тонкие пленки ZnO и диодные структуры на его основе являются объектами многочисленных исследований научного и прикладного характера. В частности, были достигнуты значительные успехи в создании газовых сенсоров, варисторов, дисплеев и т. д. В опубликованной нами ранее работе [1] были изложены результаты исследования электрических и фотоэлектрических характеристик изотипной гетероструктуры *n*-ZnO–*n*-Si и ее возможного практического использования.

Настоящая работа посвящена исследованиям механизма токопереноса и фотоэлектрических свойств анизотипной гетероструктуры с контактом Шоттки p-Si- $n^+$ -ZnO-n-ZnO-Pd. Отметим, что оба элемента этой структуры p-Si- $n^+$ -ZnO и ZnO-Pd были опробованы ранее соответственно как солнечные элементы [2] и детекторы водорода [3].

Процесс создания структур включал три последовательных этапа. Вначале на подложку p-Si наносился проводящий слой *n*<sup>+</sup>-ZnO путем осаждения из металлорганических соединений и в качестве источника использовался ацетилацетонат цинка  $Zn(A_cA_c)_2$ . Процесс проводился в реакторе вертикального типа на подложку, поддерживаемую при температуре 300-350°С. Был использован Ar, насыщенный парами  $Zn(A_cA_c)_2$  и кислорода. Осаждение слоев n<sup>+</sup>-ZnO осуществлялось при температуре источника с ацетилацетонатом цинка равной 120°С и в потоке аргона с кислородом в соотношении  $[Ar]/[Ar + O_2] = 0.5$ . Слои  $n^+$ -ZnO имели толщину 0.15 мкм, концентрацию электронов  $(5-8) \cdot 10^{19}$  см<sup>-3</sup> и подвижность  $\sim 50 \,\mathrm{cm}^2/\mathrm{B} \cdot \mathrm{c}$ . Далее наносился тонкий слой *n*-ZnO методом электронно-лучевого испарения кристаллов *n*-ZnO ( $\rho \simeq 10^2 \, \text{Om} \cdot \text{сm}$ ); толщины слоев составляли 100-300 Å. Наконец, путем напыления в вакууме наносился слой Pd толщиной ~ 400 Å. Общая схема структуры дана на рис. 1, а.

На созданных образцах структур измерялись стационарные вольт-амперные характеристики (BAX) и фотоэлектрические параметры структур с использованием стандартных измерительных схем и приборов.

На рис. 2 приведена типичная зависимость прямого тока (положительный потенциал на Pd) от приложенного напряжения для одного из образцов, измерения при  $T = 300^{\circ}$ К. Наблюдаются два степенных участка ВАХ: на первом (для различных образцов)  $I \propto V^{1.2-1.5}$ 

(до  $V \leq 0.2$  В) и на втором  $I \propto V^3$ . На рис. 3 представлена спектральная фоточувствительность структуры в области длин волн  $\lambda > 0.6$  мкм. Она характерна наличием двух относительно узких полос с  $\lambda_{\rm max} = 0.95$  и 2.65 мкм. Первая, очевидно, определяется величиной фотоэдс гетероперехода  $n^+$ -ZnO–p-Si, вторая, более слабая по абсолютной величине фотосигнала, — барьером Шоттки n-ZnO–Pd.

Отличительной особенностью механизма токопереноса в структуре является отрицательная фоточувствительность, т.е. уменьшение (гашение) темнового прямого тока  $I_d$  при возбуждении светом из спектрального интервала 0.7–1.2 мкм (рис. 4). Спектральная кривая гашения представляет собой перевернутую кривую фоточувствительности (см. рис. 3). При обратном смещении наблюдается только положительная фоточувствительность.

Приложенное прямое смещение распределяется по трем областям структуры:

$$V = V_1 + V_2 + V_3, \tag{1}$$

где  $V_1$  — падение напряжения на барьере Шоттки Pd-*n*-ZnO,  $V_2$  — напряжение на слое *n*-ZnO,  $V_3$  — напря-



**Рис. 1.** Технологическая схема (a) и предполагаемая зонная схема (b) структуры p-Si- $n^+$ -ZnO-n-ZnO-Pd.



**Рис. 2.** Прямая ветвь вольт-амперной характеристики структуры *p*-Si-*n*<sup>+</sup>-ZnO-*n*-ZnO-Pd.



**Рис. 3.** Спектральная фоточувствительность структуры *p*-Si-*n*<sup>+</sup>-ZnO-*n*-ZnO-Pd.

жение на гетерогранице  $n^+$ -ZnO–p-Si. Наличие протяженной области кубической зависимости тока от напряжения на ВАХ дает основание предположить, что основная часть приложенного смещения падает на слой n-ZnO и в этой связи можно считать, что  $V_2 \gg V_1$  и  $V_2 > V_3$ . Такая степенная зависимость I(V) характерна для механизма двойной инжекции носителей в дрейфовом приближении. Согласно теории,

$$I \approx \mu_n \mu_p \tau_p V^3 / L^5, \qquad (2)$$

где L — толщина высокоомного слоя (*n*-ZnO),  $\mu_{n,p}$  — подвижности электронов или дырок,  $\tau_p$  — время жизни дырок.

Грубая оценка величины  $\tau_p$  из этого соотношения при  $\mu_p \ll 1 \text{ см}^2/\text{B}\cdot\text{c} \leq \mu_n$  показывает очень низкую величину порядка или менее  $10^{-10}$  с. Инжекция электронов в слой *n*-ZnO идет со стороны *n*<sup>+</sup>-ZnO (рис. 1, *b*), а инжекция дырок — со стороны Pd. Как показано в работе [4],

соотношение (2) вытекает из условия, что распределение инжектированных дырок имеет резко выраженный минимум. В нашем случае этот минимум находится ближе к гетерогранице Pd-*n*-ZnO. Время пролета электронов

$$t_{\rm tr} = \frac{L^2}{\mu_n V}$$

в нашем случае составляет 10<sup>-11</sup>-10<sup>-12</sup> с и соответствует условиям так называемой диэлектрической релаксации, когда  $t_{\rm tr} \ll \tau_{\rm M}, \tau_p$ , где  $\tau_{\rm M}$  — время максвелловской релаксации. В этом режиме роль термически равновесных носителей несущественна, и нейтрализация объемного заряда осуществляется инжектируемыми электронами и дырками. В этой области не наблюдается эффекта отрицательной фоточувствительности. Он характерен для переходной области ВАХ при невысоких уровнях инжекции. На наш взгляд, объяснить механизм гашения прямого тока светом в исследованных структурах можно основываясь на особенностях механизма захвата и рекомбинации носителей в слое n-ZnO. Аналогичный эффект (отрицательная фотопроводимость) наблюдался в Ge при генерации неосновных носителей на уровень примеси [5]. Проблема возможного увеличения сопро-



**Рис. 4.** Гашение тока светом  $(I_d - I_l)$  в диодной структуре *p*-Si-*n*<sup>+</sup>-ZnO-*n*-ZnO-Pd в зависимости от длины волны излучения;  $I_d$  — темновой ток,  $I_l$  — ток при освещении структуры. На вставке — положительная фоточувствительность при возбуждении инфракрасным излучением в диапазоне  $\lambda = 2.6 - 2.7$  мкм.



**Рис. 5.** Гашение темнового тока  $I_d$  в зависимости от интенсивности  $\theta$  возбуждающего излучения ( $\lambda = 0.98$  мкм).

Физика и техника полупроводников, 2001, том 35, вып. 4

тивления в полуизоляторах при инжекции неосновных носителей обсуждалась, в частности, в [6].

В нашем случае можно предположить, что в результате технологического процесса создания структуры, и в особенности слоя n-ZnO, в нижней половине запрещенной зоны этого слоя образовались скомпенсированные акцепторные уровни  $E_{ai}$  (рис. 1, b). Эти уровни, естественно ожидать, должны обладать высоким сечением захвата неосновных носителей, дырок. Возможно, что один из уровней  $E_{ai}$  имеет большую концентрацию  $N_{a1}$  и наиболее эффективен в процессе рекомбинации. Уровень Е<sub>d</sub> донорного типа лежит выше равновесного уровня Ферми  $E_{\rm F}$  и энергия ионизации  $E_d \gg kT$ , т.е. скорость термического возбуждения электронов в зону проводимости, пропорциональная  $\gamma m \exp(-E_d/kT)$ , невелика (т — число заполненных центров). При возбуждении светом с длиной волны, соответствующей собственному поглощению кремния, на гетеропереходе генерируются электронно-дырочные пары, создающие фототок. При этом неравновесные электроны термализуются в слое  $n^+$ -ZnO, а дырки, неосновные носители в n-ZnO, захватываются на эффективные рекомбинационные центры E<sub>a1</sub> в этом слое. Для этих центров вероятность рекомбинации пропорциональна произведению коэффициента захвата электронов  $\gamma_n$  на концентрацию темновых носителей n, причем

$$\gamma_n n > \gamma_p P_{\rm v} \exp\left(-\frac{E_g - E_{ai}}{kT}\right),\tag{3}$$

где *P*<sub>v</sub> — эффективная плотность состояний в валентной зоне, и коэффициент захвата электронов  $\gamma_n$  больше коэффициента захвата центрами Е<sub>d</sub>. В этих условиях высокая скорость рекомбинации световых неравновесных дырок с темновыми электронами приводит к гашению прямого темнового тока. Величина гашения, определенная как  $I_d - I_l$  ( $I_d$  — темновой ток,  $I_l$  — ток при освещении структуры), зависит от концентрации неравновесных дырок и возрастает с ростом интенсивности света (рис. 5). Характерная спектральная кривая гашения (рис. 4), очевидно, связана с изменением коэффициента собирания электронно-дырочных пар. Высокая скорость рекомбинации на границе раздела  $n^+$ -ZnO-p-Si, вероятно, сильно снижает этот коэффициент; то же самое происходит на длинноволновом участке. В обоих случаях соответственно снижается поток световых дырок на уровни  $E_{a1}$ , падает темп рекомбинации, что приводит к кривой гашения, напоминающей перевернутую кривую спектральной фоточувствительности. Высокой скоростью поверхностной рекомбинации и в прилегающем слое объемного заряда можно объяснить узкую полосу фотоответа с  $\lambda_{\rm max} = 2.65$  мкм. Эту полосу мы связываем с переходом электронов через барьер Шоттки из Pd в слой n-ZnO. В этой полосе наблюдалась только положительная фоточувствительность (см. вставку на рис. 4). Это подтверждает предположение, что определяющую роль в возникновении отрицательной фоточувствительности в структурах играет генерация неосновных носителей.

Следует отметить, что измерения температурной зависимости гашения показали, что этот эффект наблюдается при T > 120 K, увеличиваясь с ростом температуры. При T < 120 K обнаруживается только положительная фоточувствительность. Это указывает на ограниченные условия наблюдения гашения тока светом. При низких температурах падает концентрация темновых носителей и изменяется положение уровня Ферми по отношению к уровням  $E_d$  и  $E_{a1}$ , что резко изменяет механизмы захвата и рекомбинации и приводит к исчезновению эффекта гашения.

## Список литературы

- С.В. Слободчиков, Х.М. Салихов, Е.В. Руссу. ФТП, 33, 435 (1999).
- [2] M. Shimizu, T. Horii, T. Shiosaki, A. Kawabata. Thin Sol. Films, 96, 149 (1982).
- [3] K. Ito. Surf. Sci., 86, 345 (1979).
- [4] Э.И. Адирович, П.М. Карагеоргий-Алкалаев, А.Ф. Лейдерман. Токи двойной инжекции в полупроводниках (М., Сов. радио, 1978) гл. 3, с. 115.
- [5] F. Stöckmann. Zs. Phys., 143, 348 (1955).
- [6] C. Popescu, H.K. Henisch. Phys. Rev., 14 (2), 517 (1976).

Редактор Т.А. Полянская

## The quenching of current by light in p-Si- $n^+$ -ZnO-n-ZnO-Pd diode structures

S.V. Slobodchikov, Kh.M. Salikhov, E.V. Russu, Y.G. Malinin

loffe Physicotechnical Institute, Russian Academy of Sciences, 194021 St. Petersburg, Russia